



kingston.com/epop

ePoP

Memória ePoP – Embedded Embalagem-on-Embalagem para "wearables"

A ePoP da Kingston oferece um componente padrão JEDEC altamente integrado que combina armazenamento Embedded MultiMedia Card (e-MMC) e Low-Power Double Data Rate (LPDDR) DRAM dentro de uma solução Embalagem-on-Embalagem (PoP). A ePoP é montada diretamente no topo de um System-on-a-Chip (SoC) host compatível, que reduz espaço do Printed Circuit Board (PCB) e garante um desempenho excelente. A ePoP é uma solução ideal para aplicações de espaço restrito como "wearables".

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Ao montar diretamente no topo de um SoC host, a ePoP fornece a solução ideal para aplicações de tamanho pequeno como os "wearables".
- Firmware de armazenamento otimizado e DRAM de baixa tensão reduz o consumo de energia enquanto entrega o alto desempenho necessário para aplicações "wearable".
- Simplifica o design do sistema, reduz o tempo para o mercado e encurta o ciclo de qualificação.
- Configurações de firmware múltiplas disponíveis para melhor se adequar às exigências de sua aplicação em relação ao desempenho, energia e vida útil.

SEGMENTOS DE MERCADO



IoT



Wearables



Dispositivos de Realidade Aumentada (RA) / Realidade Virtual (RV)

EPOP CÓDIGO DO PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES

ePoP com base em LPDDR3

Código do Produto	Capacidade		Padrão		Embalagem (mm)	FBGA	Temperatura de Operação
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM			
04EP04-N3GM627	4	4	5,0	LPDDR3	10x10x0,8	136	-25°C ~ +85°C
04EP08-N3GM627	4	8	5,0	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C
08EP08-N3GTC32*	8	8	5,1	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C
32EP08-N3GTC32	32	8	5,1	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C

ePoP com base em LPDDR4x

Código do Produto	Capacidade		Padrão		Embalagem (mm)	FBGA	Temperatura de Operação
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM			
08EP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
08CP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,85	144	-25°C ~ +85°C
16EP08-M4ETC32	16	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP08-M4ETC32	32	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
16EP16-M4FTC32	16	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32CP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,85	144	-25°C ~ +85°C

*modo pSLC para maior resistência

